

Title (en)

Apparatus for pickling strips or wires

Title (de)

Vorrichtung zum Beizen von band- oder drahtförmigem Material

Title (fr)

Appareil de décapage de bandes ou de fils

Publication

EP 1333109 A2 20030806 (DE)

Application

EP 03000498 A 20030113

Priority

AT 1772002 A 20020204

Abstract (en)

Device for pickling strip- or wire-like material (1) comprises guiding units for the material, and units for contacting the material with a pickling liquid. At least two vertical pickling cells (3, 3a) each with two vertical rods (4, 6) are provided which can be independently switched. Preferred Features: The units for contacting the material with a pickling liquid comprise overflows (11). High pressure nozzles for spraying the pickling medium onto the material are provided in the pickling cells. The device further comprises units for subjecting the material to a current.

Abstract (de)

Eine Vorrichtung zum Beizen von band- oder drahtförmigem Material (1) weist Führungseinrichtungen (2, 5, 7) für das Material in mehreren Schlangen mit vertikalen Abschnitten (4, 6) und Einrichtungen (11), um das Material mit einer Beizflüssigkeit (9) in Kontakt zu bringen, auf. Um selbst bei rein chemischem Beizen eine exakte Veränderung bzw. Einstellung der wirksamen Beizlänge und damit eine genau bestimmbare variable Beizwirkung bei platzsparender Bauweise der Anlage zu ermöglichen, sind zumindest zwei vertikale Beizzellen (3, 3a) mit je zwei vertikalen Strängen (4, 6) vorgesehen, und sind die einzelnen Zellen (3, 3a) wahlweise und unabhängig voneinander zu- und wegschaltbar. <IMAGE>

IPC 1-7

C23G 3/02

IPC 8 full level

B08B 3/02 (2006.01); **C23G 3/02** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

C23G 3/02 (2013.01 - EP KR US); **C23G 3/023** (2013.01 - EP US)

Cited by

CN102825019A

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1333109 A2 20030806; **EP 1333109 A3 20040818**; AT 413217 B 20051215; AT A1772002 A 20050515; JP 2004000903 A 20040108; KR 20030066430 A 20030809; US 2004226579 A1 20041118

DOCDB simple family (application)

EP 03000498 A 20030113; AT 1772002 A 20020204; JP 2003013821 A 20030122; KR 20030006615 A 20030203; US 35672803 A 20030203